

Produktinformation

FELDER-ISO-Tin[®] „Sn100Ni+ Refill“ Massivdraht

Bleifreies Nachfülllot für Selektivlötanlagen
Sn99,9NiGe nach Fuji- Pat. No. DE19816671C2,

Art.-Nr.: 551499....

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Anwendung

Um den Eintrag von Kupfer in die bleifreie Legierung Sn100Ni+ in Selektivlötanlagen auszugleichen empfehlen wir unser **FELDER-ISO-Tin[®] „Sn100Ni+ Refill“**.
 Eine regelmäßige Überprüfung des Lotbades ist hierzu unumgänglich.

Eigenschaften

Da die meisten Platinen und Bauteile verkupferte Leiterbahnen und Anschlüsse haben, wird Kupfer durch den Lötprozess in das Lötbad gespült. Zwar hat Sn100Ni+ eine geringere Cu-Ablegerungsrate als andere bleifreie Lote, dennoch ist ein Cu-Niveauausgleich notwendig.

Legierung: Sn99NiGe
 Schmelzpunkt: 232°C (reduziert sich im Bad auf 227°C!)

Verunreinigungen/Toleranzen

Element	Ag	Al	As	Bi	Cd	Cu	Fe
Gehalt (%)	<0,060	0,001	0,030	0,050	0,002	<0,050	0,020
Element	Ge	Ni	Pb	Sb	Sn	Zn	
Gehalt (%)	0,01±0,005	0,06±0,02	0,040	0,050	99,9±0,05	0,001	

Lieferformen

Drahtdurchmesser: 0,5 - 5,0 mm (spezielle Drahtdurchmesser sind auf Wunsch lieferbar)

Standardspulengrößen: 0,05 - 15,0 kg (Kunststoffspulen mit Nettogewicht)

Sonderspulengewichte (z. B. in Lbs) auf Wunsch lieferbar.

Hinweise

Bleifreie FELDER-ISO-Tin[®] Elektroniklote enthalten keinerlei Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS II“) Beschränkungen bestehen.

Bei konstantem Raumklima unbegrenzt haltbar.

Andere Legierungen sind in unserem Standardlieferprogramm enthalten.